

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒一对一沟通 ☒其他（电话会议）
参与单位 及人员	富国基金、永赢基金、华夏基金、混沌投资、银华基金、融通基金、交银施罗德基金、中欧基金、国联安基金、长信基金、信达澳亚基金、申万菱信基金、国泰基金、兴业基金、大成基金、海创基金、德邦基金、中邮基金、神采基金、华泰柏瑞基金、华富基金、丹羿投资、九沅投资、趣时资产、量利资产、禹田资本、平安人寿、平安资管、开源证券自营、财通资管、北大方正人寿资管、浙商资管、益恒投资、国源信达资本、国海证券、国信证券、浙商证券、财通证券、广发证券、中信建投证券、银河证券、华源证券、Optimas Pinpoint
时间	2026 年 9 月 4 日
地点	上海浦东香格里拉酒店、上海锦江汤臣洲际酒店、陆家嘴禧玥酒店、各机构会议室及线上会议
接待人员	董事会秘书常亮先生
投资者关 系活动主 要内容介 绍	一、2026年上半年业绩的说明 报告期内，公司采取措施继续优化成本和产品结构，进一步完善产品技术指标并拓展销售网络，加强研发工作，力图不断满足新增市场需求。公司实现营业收入21,640.56万元，相比去年同期增长3.78%；取得归属于上市公司股东的净利润4,108.54万元，相比去年同期下降15.87%。公司在确保生产质量和产能扩张的同时，优化了客户结构和销售结构，夯实了经营基础。 二、大直径硅材料业务的说明 大直径硅材料业务受到海外市场景气度提升带动，实现营业收入13,513.72万元，同比增长46.05%，较去年同期有较大幅度增长； 根据国际主流刻蚀机设备厂商和集成电路制造厂商披露的财务数据，集成电

	路制造厂商产能利用率持续提升，存量市场向好。 公司将根据市场需求情况实施大直径硅材料业务的产能扩充。公司还将密切跟踪国际半导体供应链的重组态势，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验和资源，扩大面向海外市场的出口产品品类和数量，响应供求关系和成本端的变化，适时适度地调整产品销售价格。 三、硅零部件业务的整体说明 硅零部件业务受下游客户采购计划调整的影响，报告期内实现营业收入6,899.07万元，同比减少38.57%。公司在按照既定战略持续扩充产能的同时，针对性地优化产能配置和客户结构，已取得成效；公司具备“从硅材料到硅零部件”的全产业链优势以及前瞻性研发布局，技术储备雄厚、产品种类丰富，且产品结构聚焦于高技术、高毛利产品。 公司认为，长期高品质大批量交付能力的构建，重要性大于短期订单波动。公司硅零部件产品已经全面导入国产等离子刻蚀机设备厂商及集成电路制造厂商，客户结构得以优化，未来有望获得更大的成长空间和更强的成长动能。 四、硅零部件业务客户结构的说明 公司硅零部件产品已经全面导入国产等离子刻蚀机设备厂商及集成电路制造厂商。因此，既可以满足国产刻蚀机设备原厂的工艺配套研发协同需求，也可以满足集成电路制造厂工艺改进需求以及Second-Source降本保供需求，两者并行不悖。 中国集成电路制造厂的刻蚀设备国产化进程，以及中国本土刻蚀设备厂的自主工艺研发和标准化进程，仍将在中长期持续进行，持续产生对上游零部件及材料的定制化自主可控需求；海外刻蚀设备机台因其技术特性以及部分国家对华半导体零部件贸易管制，将持续产生标准件的Second-Source和微调改进需求。 对于公司而言，由于已经掌握上游大直径硅材料的全尺寸技术能力和全球领先的产能，现阶段就所谓“直供晶圆厂”和“配套设备厂”两种模式，不存在“非此即彼”或“厚此薄彼”之主观区分。上半年，公司“直供晶圆厂”的硅零部件收入增长显著，长期高品质大批量交付能力持续完善。 五、半导体大尺寸硅片业务的说明 半导体大尺寸硅片业务受益于行业整体回暖和竞争格局改善。公司抓住市场
--	---

	机遇，已经实现面向重点客户的小批量出货，利基细分市场培育亦取得显著成果，开工率有所提升。报告期内，该业务实现营业收入1,110.33万元，同比增长达268.98%，毛利率为-5.05%，较去年同期明显提升并接近转正。报告期内，公司投资设立了全资子公司北方晶圆半导体科技（北京）有限公司作为该业务未来高质量差异化发展的承载主体。 六、新增重要非主营业务的说明 公司通过控股子公司锦州精辰半导体有限公司，开展碳化硅陶瓷零部件业务。碳化硅陶瓷零部件具备耐高温、耐等离子腐蚀、高热导率、高纯度等优异特性，可广泛应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入、外延、退火、氧化、扩散等多类半导体设备，是先进制程芯片制造的关键核心耗材。公司计划实施“碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目”，有望实现高纯碳化硅陶瓷零部件的研发与产业化落地，进一步完善“硅基材料+硅基部件+陶瓷部件”平台化产品布局，拓展产品应用场景与市场空间，提升综合竞争力与持续经营能力。 七、公司对新品类拓展的基本战略考量 中国本土集成电路制造厂的迅猛发展，具备孕育出世界级平台型半导体材料及零部件配套商的条件。 公司现阶段的产品布局，简而言之，即“硅基材料+硅基部件+陶瓷部件”，以高价值耗材为目标产品。该布局具备清晰的上下游产业逻辑和内在一致性。浪战无益，力出一孔，公司致力于在主航道上拉开与竞争对手的差距。 对于新品类拓展，公司认为需要在上游配套能力、客户需求和自身能力之间求得平衡，尊重全球半导体产业的客观历史规律及中国大陆产业配套能力的现实条件，先胜而后求战。 八、市场展望及经营计划 展望下半年市场机遇，公司认为，中国本土厂商以超大规模国内统一大市场为基础，通过“规模降本-技术迭代-产业链闭环-建立行业标准”的路径，后发先至取得全球产业竞争制高点之范式，在过去十年的LCD面板、光伏、动力电池、
--	--

	碳纤维等领域得到反复验证。因此，中国本土芯片制造厂商有望加速成长为世界级公司。 相比海外竞争对手的积累而言，包括公司在内的本土半导体材料和零部件企业，普遍设立时间较短、经验有限、资源不足。如何在短时间内匹配世界级客户的世界级需求，既是挑战更是机遇。国产化的战略任务，对中国本土厂商的生产管理、供应链建设、智能化管理水平、资本运作能力乃至企业文化建设，提出了全方位的跃升要求。用进废退，不进则退，产业竞争已经从“资格赛”和“小组赛”，进入到“排位赛”和“淘汰赛”。 公司积极主动地应对上述产业机遇、战略任务和竞争态势。报告期内，公司第三届董事会第十四次会议和 2026 年第二次临时股东会通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，计划向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 100,000 万元，投向三大项目——“硅零部件扩产项目”、“碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目”、“研发中心建设项目”。 公司将积极把握半导体市场特别是存储芯片市场境内外“同频共振”的历史机遇，计划实现大直径硅材料业务境外市场的收入突破，保质保量完成硅零部件业务的产能扩充并持续优化客户结构，推动半导体大尺寸硅片业务的盈利能力改善和高质量差异化发展。公司还将密切研判当前地缘政治经济宏观事件频发态势下的国际半导体供应链重组动向，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验和资源，为股东创造价值。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 7 日